

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260918

投资者关系 活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称 及人员姓名	2026 年 9 月 17 日上午 9:00~11:30：阳光资产：李衡、王逸峰、王曦、陈柯、付万丛、黄皓、华丁垚，长盛基金：滕光耀，银河证券：赵中兴、张保和、李新，富国基金：于鹏、陈乐，共 13 名投资者及证券人员 2026 年 9 月 17 日下午 14:00~15:30：国寿：闫凌云、李梅、赵斯彤、刘哲铭、陈烈钦、郭琳、洪奕昕，中信建投：汪洁、朱源哲、陈姝宏，共 10 名投资者及证券人员
时间	2026 年 9 月 17 日上午 9:00~11:30；2026 年 9 月 17 日下午 14:00~15:30
地点	公司 9 楼会议室
上市公司接待 人员姓名	2026 年 9 月 17 日上午 9:00~11:30：投资者关系总监熊亚威先生 2026 年 9 月 17 日下午 14:00~15:30：投资者关系总监熊亚威先生
投资者 关系活动 主要内容 介绍	公司介绍： 鼎龙股份是国内领先的以半导体材料为核心的创新材料平台型公司。公司现以半导体材料为重点，产品覆盖集成电路制造、先进封装、半导体显示等多个细分领域；同时拓展锂电关键功能性辅材，发力新能源赛道，并持续在其他重点应用领域的创新材料端进行拓展布局。此外，公司积极开拓成熟材料产品的海外市场，同步推进国际一流水平的前沿材料研发，致力于成为全球化创新材料平台标杆。 问 1：公司 2026 年上半年研发投入情况如何？ 答：公司始终高度重视研发投入，将技术创新作为核心发展战略，长期保持高水平的研发投入力度。2026 年上半年度，公司研发投入金额为 2.96 亿元，较上年同期增长 18.69%，占营业收入的比例为 15.39%，为各类新产品及配套资源的快速布局提供了坚实支撑，综合创新能力得到进一步巩固与提升。研发投入的增长主要系 CMP 抛光液、高端晶圆光刻胶业务对产品型号系统布局的要求较高，以及半导体先进封装材料等新业务的持续投入所致。公司研发方向严格围绕半导体核心耗材国产替代展开，重点聚焦高端晶

	圆光刻胶、全系列 CMP 材料、先进封装材料、半导体显示材料等关键领域，精准攻坚国内半导体产业的材料难题，并同步推进锂电关键功能性辅材等新赛道的前瞻性技术布局。在研发体系建设方面，公司坚持 "四个同步" 发展理念，构建了 "基础研究 - 中试放大 - 量产落地" 一体化的研发平台，形成覆盖有机合成、高分子合成、无机非金属、物理化学等多领域的七大核心技术平台，并建成 CMP 抛光材料、新型显示材料、先进封装材料、晶圆光刻胶、打印复印关键材料五大应用评价验证体系，持续强化从技术研发到产品落地的全链条创新能力。在知识产权建设方面，截至 2026 年 6 月 30 日，公司已获授及在申请中的专利共 809 项，其中已获得授权的专利 611 项（含发明专利 335 项、实用新型专利 206 项、外观设计专利 70 项），拥有软件著作权与集成电路布图设计 108 项，围绕 CMP 抛光垫、抛光液、光刻胶、柔性显示 PSPI 等重点产品持续完善专利布局，构建起坚实的企业创新发展知识产权护城河。未来公司将持续保持高水平的研发投入规模，优化研发资源配置，加快新产品送样验证与量产转化节奏，以持续的技术创新巩固行业领先地位，为公司长远发展筑牢根基。 问 2：今年上半年度公司的显示材料情况怎么样？ 答：公司半导体显示材料业务围绕柔性 OLED 显示面板制造上游关键核心材料布局，是公司半导体材料板块的重要组成部分。2026 年上半年度，公司半导体显示材料实现产品销售收入 2.36 亿元。公司在显示材料领域的产品竞争力、市场地位及新一代产品布局持续深化，业务发展动能不断积蓄。在产品地位方面，公司黄色聚酰亚胺浆料 YPI、光敏聚酰亚胺浆料 PSPI、薄膜封装材料 TFE-INK 产品已在客户端规模销售，并已成为国内部分主流面板客户 YPI、PSPI 产品的第一供应商，确立 YPI、PSPI 产品国产供应领先地位，行业龙头地位稳固。在高世代产线突破方面，公司 PSPI、TFE 封装墨水等产品实现 G8.6 高世代 AMOLED 产线批量供货，在全球首批实现商业化量产的 G8.6 代 AMOLED 产线上实现首发批量配套供应，充分彰显了公司在高世代显示材料领域的供应能力与技术实力，为公司把握中大尺寸 OLED 产业化机遇奠定了坚实基础。在新一代产品研发方面，公司对标国际一流，持续深化新一代 OLED 显示材料创新布局：无氟光敏聚酰亚胺（PFAS Free PSPI）、黑色像素定义层材料（BPDFL）等产品各项性能指标均达到国内领先水平，客户端验证工作有序推进；低介电 INK 等新一代显示材料持续开发，拓展高世代、中大尺寸显示面板用关键材料的升级迭代；PI 取向液产品开发进程加快，客户端验证工作已全面铺开。随着中大尺寸 OLED 产业化进程的持续推进，公司显示材料业务有望打开新的成长空间，成为公司半导体材料业务的新增长极。 问 3：公司近期在光通信材料领域有所布局，请问公司切入该领域的战略原因是什么？ 答：随着 AI 算力需求的爆发，光通信产业正加速向更高速率方向迭代演进，对上游核心材料的性能突破与工艺革新不断提出更高要求，而高端光通信核心材料的规模化落地长期受技术壁垒与供应链瓶颈制约，核心材料国
--	--

	产化已成为产业发展的必然趋势；公司作为国内领先的关键大赛道领域创新材料平台型企业，基于对行业趋势的深入研判，依托多年积累的 "一体化材料平台" 优势，将底层技术高效迁移至光通信领域，正式切入光通信材料赛道，致力于为行业提供高可靠、定制化的全链条材料解决方案。本月公司携光通信材料产品矩阵首次亮相第二十七届中国国际光电博览会，实现该业务线在行业盛会中的首次公开集体亮相。展望未来，公司将持续深化 "一体化材料平台" 战略，以底层技术迁移与跨领域协同创新为抓手，紧跟光通信产业向更高速率、更大带宽、更低时延演进的行业浪潮，充分发挥全链条自主制备优势，助力产业链技术升级与核心材料国产化进程，为公司长期高质量发展持续培育新的增长动能。 问 4：请问光通信材料和现有技术平台有无什么关联？ 答：在技术协同方面，公司作为国内少数同时掌握高端晶圆光刻胶、封装光刻胶、显示光刻胶三大品类的平台型企业，将底层技术高效迁移至光通信领域：从光刻胶技术延伸至光纤涂层，以粉体技术赋能导热凝胶，以高分子合成能力支撑光学耦合胶研发，同源技术让跨领域创新成为现实。同时，公司具备有机合成、高分子合成、精制纯化、配方开发及混配等全流程自主制造能力，并配套严苛的数字化品控体系，能够为下游客户提供稳定、高效的批量交付保障，构筑起 "前沿研发 + 自主制造" 的闭环能力。目前，上述光通信材料产品依托公司一体化平台协同研发，多款产品已向下游客户送样验证，部分产品有望年内实现订单突破。本次参展光博会是公司布局光通信领域的全新起点，未来公司将紧跟光通信产业向更高速率、更大带宽、更低时延演进的行业浪潮，持续深化 "一体化材料平台" 战略，以底层技术迁移与跨领域协同创新为抓手，充分发挥全链条自主可控优势，助力光通信核心材料国产化进程与产业链技术升级，为产业高质量发展持续贡献力量。 问 5：公司今年上半年度现金流状况如何？ 答：2026 年上半年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 5.67 亿元，较上年同期增长 29.26%，现金流状况稳健，为公司各项业务的发展与战略投入提供了有力支持。从现金流质量来看，本报告期公司经营性现金流量净额高于同期归母净利润水平（归母净利润 5.29 亿元），经营性现金流与经营成果相匹配，盈利的现金含量较高。这主要得益于：一是受益于全球半导体产业拓展与技术迭代，公司半导体材料业务多品类放量增长，整体销售规模扩大，带动经营性现金流入稳步增加；二是公司持续推进降本控费工作，强化工艺、能耗、集采、设备维保等关键环节的精细化管控，运营效率与盈利能力持续提升；三是公司完成打印复印通用耗材终端业务出表并新并购皓飞新材，业务组合与资产结构进一步优化，盈利质量与财务稳健性进一步夯实。同时，公司维持较高研发投入力度（研发投入金额 2.96 亿元），并持续推进各产业基地产能建设与前瞻性布局。稳健的经营性现金流为公司高强度研发创新、产能建设及新业务拓展提供了坚实保障，财务结构稳健，抗风险能力持续增强。
--	--

附件清单	无
日期	2026 年 9 月 18 日